

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录汇总表

(2024年12月20日)

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	华金证券 王臣复、华金证券 王海维、华金证券 宋鹏、华金证券 吴家欢、民孚资产 吴元青、新华基金 金曦、先锋基金 杜旭
<b>会议时间</b>	2024年12月20日 10:30-11:30
<b>会议地点</b>	佰维存储三楼会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书、财务总监 黄炎烽 董办工作人员
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>Q1. 存储行业未来发展趋势是什么？公司如何把握行业机遇？</b>            A1：下一代信息技术与存储器技术发展密不可分。物联网、大数据、人工智能、智能车联网、元宇宙等新一代信息技术既是数据的需求者，也是数据的产生者。目前存储器国产化率较低，存储芯片的国产化率将随着市场和政策的双向推动大幅提升，国产存储产业前景广大。公司是业内最早布局研发封测一体化的企业，从2010年开始就自建封测能力，有十几年的积累沉淀，存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平；公司在现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力，不断提升技术壁垒；此外，公司也是业内率先进行主控自研存储解决方案的企业，在可控性能和国产化等方面具备竞争优势。</p> <p><b>Q2. 公司为何积极构建晶圆级先进封测能力？将采取什么措施来推进相关布局？</b>            A2：由于5G、物联网和人工智能等新兴行业迅速发展，下游企业对先进封测的需求持续上升。先进封装技术的发展方向不断向晶圆级封装领域和系统级封装领域发展，公司需不断进行技术创新才能适应市场变化。公司将顺应集成电路下游应用市场集成化、小型化、智能化和定制化的发展趋势，加强构建在先进封装领域的研发、制造、测试能力，提升技术竞争力，扩大市场占有率，以适应行业日益提高的技术要求。</p> <p><b>Q3. 公司在消费级存储市场有哪些布局？如何提升在这个领域的品牌影响力？</b>            A3：公司运营公司自主品牌佰维（Biwin），并获得惠普（HP）、宏碁（Acer）、掠夺者（Predator）的存储类产品全球独家运营授权，以及联想（Lenovo）在海外区域市场的存储器产品运营授权，开发PC后装、电子竞</p>

技、移动存储等消费级存储市场，并取得良好的市场表现。公司将进一步深化渠道布局，丰富产品品类，持续拓展国内外个人消费市场。

**Q4. 近期 AI 概念热度持续上升，公司在 AI+硬件应用场景上有哪些布局？**

A4：公司在受 AI 驱动的大容量闪存和内存产品布局上比较全面，满足 AI 端侧设备对存储配置提升的需求。在智能手机领域，随着 AI 大模型的广泛应用，为了最大程度展现端侧 AI 的能力，目前已有不少手机厂商开始调整其旗舰产品的存储配置，公司有望受益于 AI 手机的发展；在产品方面，公司面向 AI 手机已推出 UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品，并已布局 12GB、16GB 等大容量 LPDDR 产品。在 PC 领域，AIPC 基于大模型的算力需求，对搭载大容量先进制程 DRAM 产品的需求增加，同时为了有效管理 PC 上运行的 AI 数据，也会增加对 NAND 产品的需求；公司面向 AIPC 已推出 DDR5、PCIe4.0 等高性能存储产品。在智能可穿戴领域，公司 ePOP 系列产品目前已被 Google、Meta、小天才等知名企业应用于其智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备上；基于公司研发封测一体化的布局，公司产品在可穿戴领域具有较强的竞争优势，公司自主研发也将进一步增强公司产品在穿戴领域的竞争力。

**Q5. 公司业务现在覆盖全球哪些国家和地区？**

A5：公司秉持立足中国、面向全球的发展战略。除深耕国内市场外，公司坚持贯彻全球化战略布局，在北美、拉美、印度、欧洲、中国台湾地区等地发展并打造了强有力的本地化服务、生产交付和市场营销团队。同时，公司已建立起全球经销商网络并与诸多主流销售渠道建立合作关系，目前已开拓全球客户 200 余家，覆盖全球 39 个国家和地区，在美国、巴西等 17 个国家和地区均建有经销商网络。未来，公司将借助全球化运营/交付服务网络，进一步开拓国际一流客户和各地区性市场，加强品牌形象建设，提升全球市场占有率。

**Q6. 近年来智能眼镜与 AI 技术的融合持续深化，公司在 AI 眼镜方面有什么技术积累？**

A6：公司为 Meta 最新款 AI 智能眼镜 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器，Ray-Ban Meta 智能眼镜系列搭载高通第一代骁龙 AR1 平台，该平台专门针对散热限制在功耗方面进行独特设计优化，以打造轻量化的智能眼镜。公司研发封测一体化的布局，在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。未来，公司将不断深化研发封测一体化布局，延伸公司的价值链条，增强公司的核心竞争力，为客户提供更加高效高质的存储解决方案。

**Q7. 公司研发投入持续在加大，在关键领域上实现了哪些技术突破？**

A7：公司持续加大芯片设计、解决方案研发、先进封测及存储测试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才。在芯片设计领域，公司首颗主控芯片 SP1800 实现多项国产突破，性能优异，目前已与国内某头部客户进行产品验证，进展顺利；同时，适配 QLC 大容量存储和车规存储的主控产品也在开发中。在先进封测领域，公司晶圆级先进封测制造项目正式落地东莞松山湖高

	<p>新区，预计将于 2025 年投产，为客户提供整套的存储+先进封装测试解决方案。在测试设备领域，公司自主开发了一系列存储芯片测试设备和测试算法，构建了一站式芯片测试解决方案。在企业级领域，公司发布的 CXL 2.0 DRAM 采用 EDSFF (E3.S) 外形规格，可与支持 CXL 规范及 E3.S 接口的背板和服务器主板直连，扩展服务器内存容量和带宽。</p> <p><b>Q8. 公司在企业级存储领域的当前发展状况如何？对中国企业级存储市场的未来发展趋势有何展望？</b></p> <p>A8：在企业级存储市场，公司着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作。公司打造了完善的企业级存储解决方案，不仅提供多种接口、外形尺寸和容量的固态硬盘与内存条，还积极探索与 AI 高算力相契合的前沿存储技术，推出了 CXL 内存模组，助力企业级用户构筑快速、稳定、成本效益高的数据基础设施。据 IDC 预测，2024-2028 年中国企业级存储市场预计将保持稳健的增长态势，预期复合年增长率达到 4.7%。其中，随着 NVMe 技术的普及和 SSD 磁盘阵列价格的下降，预计更多行业将选择使用全闪存阵列存储产品来建设或升级数据中心。</p> <p><b>Q9. 公司对于未来发展有哪些战略性计划？</b></p> <p>A9：公司将进一步强化研发封测一体化布局，在存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节不断突破，服务产业发展新趋势，贡献更大价值。同时，公司将持续坚持“5+2+X”的发展战略，在手机、PC、服务器等三大主要细分市场着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作；在智能穿戴和工车规市场投入战略性资源，力争成为主要参与者；持续布局芯片设计和晶圆级先进封测，打造公司二次增长曲线；对存算一体、新接口、新介质和先进测试设备等创新领域进行探索与开拓。通过以上战略布局，兼顾公司短/中/长期发展目标，推动公司持续构建新质生产力，提升公司的价值和股东回报。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2024 年 12 月 20 日
<b>备注</b>	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。